

Bundle

构造

透过正面、反面凹凸和化学有关的自黏胶带。

特征

- (1)没有黏着性，利用胶带的正反面凹凸可相互或单独贴合。
 - (2)被贴物表面即使有水也可以贴合。
 - (3)用手就可以将胶带撕开。
- 备注：可重复使用。但依贴合条件有所差异。

构成

特殊黏着层
凹凸基材
特殊黏着层

基本特性

品番	厚度 (μm)	黏着力(N/25mm) SUS	破坏强度 N/10mm		伸缩率 %	
			纵	横	纵	横
011	100	2.0	2.5	2.7	12	23

用途

IC基板的贴合
Cable的贴合
园艺用品的贴合
青菜等的贴合

使用上的注意事项

- 所有技术数据都是在共同技研(股)的实验室中进行测试和实际测量。。
但是，产品特性依环境或被贴物而有很大差异。
因此，特性数据是参考值而非保证值。
使用前，请确保本产品用途和适合环境。

保管注意事项

- 请务必存放于箱中进行保管。
- 依据保管条件特性会有劣化可能。
- 保管场所请选择不会被太阳直射的阴凉处。
尤其不要暴露在高温高湿下(温度30° C以上 湿度50%以上是严格禁止)。

共同技研化学有限公司
崎玉县所泽市南永井9 4 0 牌号
3590011
Tel : +81 4 2944 5151
Mail : info-k@kgk-tape.co.jp
URL : <https://www.kgk-tape.co.jp/>